

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 1 月 25 日 (2007.1.25)

【公開番号】特開 2005-166970 (P2005-166970A)
 【公開日】平成 17 年 6 月 23 日 (2005.6.23)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-024
 【出願番号】特願 2003-404023 (P2003-404023)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

B 0 8 B 7/00 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 A

B 0 8 B 7/00

G 0 3 F 7/20 5 2 1

H 0 1 L 21/30 5 0 3 G

H 0 1 L 21/30 5 3 1 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 12 月 4 日 (2006.12.4)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

被搬送体を収納し、大気圧に維持された供給部と、減圧又は真空雰囲気中に維持されて前記被処理体に所定の処理を行う処理チャンバとを有し、前記供給部と前記処理チャンバとの間で前記被搬送体を搬送する処理システムであって、

前記供給部と前記処理チャンバとの間に設けられ、雰囲気が置換可能であると共に前記被搬送体を 1 0 0 P a 以下の圧力で収納可能な真空室と、

前記供給部と前記真空室との間に設けられ、雰囲気が置換可能であると共に前記供給部と前記真空室との間で前記被搬送体を受け渡すための第 1 のロードロック室とを有することを特徴とする処理システム。

【請求項 2】

前記真空室と前記処理チャンバとの間に設けられ、雰囲気が置換可能であると共に前記真空室と前記処理チャンバとの間で前記被搬送体を受け渡すための第 2 のロードロック室を更に有することを特徴とする請求項 1 記載の処理システム。

【請求項 3】

前記真空室は、前記供給部と前記処理チャンバとの間で前記被搬送体を搬送する搬送手段を有することを特徴とする請求項 1 記載の処理システム。

【請求項 4】

前記被搬送体は、ウェハに転写する所望のパターンが形成されたパターン面を有するマスクであって、

前記搬送手段は、前記パターン面を重力方向に向けて搬送することを特徴とする請求項 3 記載の処理システム。

【請求項 5】

前記真空室は、前記被搬送体に付着したパーティクルを前記被搬送体から除去する除去手段を有することを特徴とする請求項 1 記載の処理システム。

【請求項 6】

前記除去手段は、パルスレーザーを用いて前記パーティクルを除去することを特徴とする請求項 5 記載の処理システム。

【請求項 7】

前記除去手段は、前記被搬送体に前記パルスレーザーを照射する照射部と、

前記照射部と前記被搬送体との間に配置され、帯電した金属部とを有することを特徴とする請求項 6 記載の処理システム。

【請求項 8】

前記除去手段は、前記パルスレーザーを照射する照射部と、

前記照射部から照射された前記パルスレーザーを反射して、前記被搬送体に照射するミラーとを有することを特徴とする請求項 6 記載の処理システム。

【請求項 9】

前記除去手段は、マイクロ波又は赤外線により前記パーティクルを燃焼させることを特徴とする請求項 5 記載の処理システム。

【請求項 10】

前記除去手段は、所定の粒子を前記被搬送体に吹き付けることで前記パーティクルを除去することを特徴とする請求項 5 記載の処理システム。

【請求項 11】

前記所定の粒子は、真空雰囲気中で気化することを特徴とする請求項 10 記載の処理システム。

【請求項 12】

前記所定の粒子は、二酸化炭素の凝固粒子であることを特徴とする請求項 10 記載の処理システム。

【請求項 13】

前記真空室は、前記被搬送体にパーティクルが付着することを抑止する抑止手段を有することを特徴とする請求項 1 記載の処理システム。

【請求項 14】

前記抑止手段は、熱泳動力を用いることを特徴とする請求項 13 記載の処理システム。

【請求項 15】

被搬送体を収納し、大気圧に維持された供給部と、減圧又は真空雰囲気に維持されて前記被搬送体に所定の処理を行う処理チャンバとを有し、前記供給部と前記処理チャンバとの間で前記被搬送体を搬送する処理システムであって、

前記供給部と前記処理チャンバとの間に設けられ、雰囲気が置換可能であると共に前記被搬送体を 100 Pa 以下の圧力で収納可能な真空室と、

前記真空室に設けられ、前記被搬送体に付着したパーティクルを前記被搬送体から除去する除去手段とを有することを特徴とする処理システム。

【請求項 16】

被搬送体を収納し、大気圧に維持された供給部と、減圧又は真空雰囲気に維持されて前記被搬送体に所定の処理を行う処理チャンバとを有し、前記供給部と前記処理チャンバとの間で前記被搬送体を搬送する処理システムであって、

前記供給部と前記処理チャンバとの間に設けられ、雰囲気が置換可能であると共に前記供給部と前記処理チャンバとの間で前記被搬送体を受け渡すためのロードロック室と、

前記ロードロック室に設けられ、前記被処理体に付着したパーティクルを前記被搬送体から除去する除去手段とを有することを特徴とする処理システム。

【請求項 17】

被搬送体を収納し大気圧に維持された供給部から、減圧又は真空雰囲気に維持されて前記被搬送体に所定の処理を行う処理チャンバに、前記被搬送体を搬送する搬送方法であって、

前記被搬送体を100Pa以下の圧力の雰囲気中に維持された空間に保持するステップと

、
前記保持ステップで100Pa以下の圧力の雰囲気下に保持された前記被搬送体に付着したパーティクルを除去するステップとを有することを特徴とする搬送方法。

【請求項18】

請求項1乃至16のうちいずれか一項記載の処理システムを有し、前記被搬送体に形成された所望のパターンをウェハに露光する露光装置、を用いて被処理体を露光するステップと、

露光された前記被処理体に現像プロセスを行うステップとを有することを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項19】

請求項1乃至16のうちいずれか一項記載の処理システムを有し、前記被搬送体に所望のパターンを露光する露光装置、を用いて被処理体を露光するステップと、

露光された前記被処理体に現像プロセスを行うステップとを有することを特徴とするデバイス製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

本発明の更に別の側面としてのデバイス製造方法は、上述の処理システムを有し、前記被搬送体に形成された所望のパターンをウェハに露光する露光装置を用いて被処理体を露光するステップと、露光された前記被処理体に所定のプロセスを行うステップとを有することを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

本発明の更に別の側面としてのデバイス製造方法は、上述の処理システムを有し、前記被搬送体に所望のパターンを露光する露光装置を用いて被処理体を露光するステップと、露光された前記被処理体に所定のプロセスを行うステップとを有することを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0024】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0025】